

1. Спосіб одержання термоеклейкої підкладки, в якому на лицеву сторону основи підкладки, що являє собою текстильну основу або основу нетканого типу, наносять у вигляді точок термопластичний полімер і піддають виворітну сторону основи підкладки електронному бомбардуванню, який **відрізняється** тим, що точки термопластичного полімеру основані на щонайменше одному функціонально заміщеному полімері, який містить функціональні групи, здатні вступати в реакцію з вільними радикалами під дією електронного бомбардування, і/або самі є генераторами вільних радикалів при впливі електронного бомбардування, та тим, що глибину проникнення електронів у точки полімеру регулюють таким чином, щоб досягти на обмеженій глибині e стосовно середньої товщини E точок полімеру самозшивання вищевказаного функціонально заміщеного полімеру.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що точки термопластичного полімеру основані на щонайменше одному функціонально заміщеному полімері, який містить функціональні групи, що включають ненасичені етиленові групи, такі як акрилатні, метакрилатні, алільні, акриламідні групи, групу вінілових ефірів, залишки стиролу, малеїнової або фумарової кислоти.
3. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що точки термопластичного полімеру основані на щонайменше одному функціонально заміщеному полімері, який містить функціональні групи, що включають лабільні фрагменти, енергія зв'язків яких менша за енергію звичайних зв'язків вуглець-вуглець або вуглець-водень.
4. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що лабільний фрагмент містить зв'язок вуглець-хлор C-Cl або тиольну групу S-H.